

# 株式会社テラプローブ 決算説明資料

2014年3月期 第3四半期

# 2014年3月期 第3四半期

## 業績説明

## 今回の発表の概要

### メモリ事業

- 日本、台湾両拠点でモバイル用メモリが好調
- ゲーム用メモリ、その他メモリの受託数量増

### システムLSI事業

- テスト受託は製品ミックス変化が影響し、低調に推移
- WLP・BUMP受託加工は数量が伸び悩み



**前四半期に比べ  
売上高は横ばいだが、利益は改善**

## 2014年3月期 第3四半期 実績

(億円)

		前年同期比較(累計)			前四半期比較		
		1-3Q/FY2012	1-3Q/FY2013	YoY増減	2Q/FY2013	3Q/FY2013	QoQ増減
	メモリ	115.1	122.0	6.9	41.9	43.1	1.2
	システムLSI	47.9	42.7	-5.2	15.6	12.7	-2.9
	その他	-0.2	-0.3	-0.1	-0.6	0.5	1.1
売上高		162.8	164.3	1.5	57.0	56.4	-0.6
	メモリ	14.3	20.5	6.2	6.5	11.9	5.4
	システムLSI	-2.1	-5.2	-3.1	-0.6	-3.6	-3.0
	その他	-10.8	-9.5	1.3	-3.1	-3.3	-0.2
営業利益		1.4	5.7	4.3	2.8	5.1	2.3
営業利益率		1%	3%	—	5%	9%	—
当期純利益		1.4	2.9	1.5	2.4	2.5	0.1
当期純利益率		1%	2%	—	4%	4%	—

## 2014年3月期 第3四半期実績増減分析(売上高)

### 2013年度第3四半期累計実績(YoY)

#### <メモリ事業>

・モバイル向け製品の増加に伴い、売上高が微増

#### <システムLSI事業>

・テスト受託は緩やかに増加したものの、  
WLP・BUMP受託数減により、売上高が減少

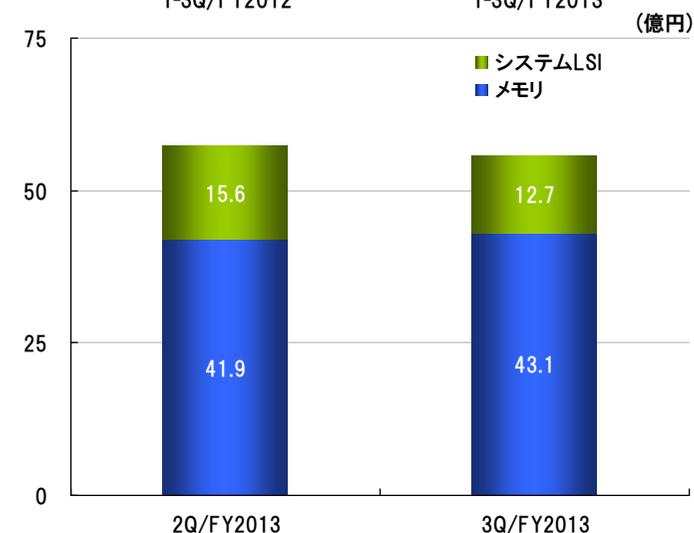
### 2013年度第3四半期実績(QoQ)

#### <メモリ事業>

・台湾でもモバイル向けが堅調  
また、ゲーム向け増により売上高も増加

#### <システムLSI事業>

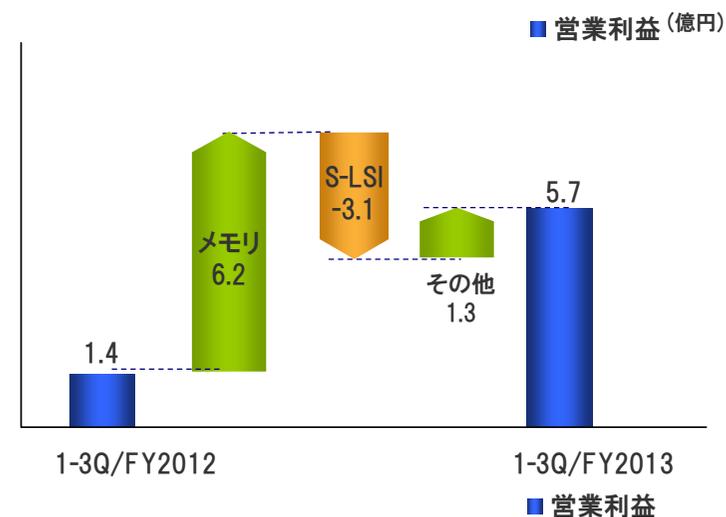
・テスト受託では、ミックスの変化により低調に推移、  
WLP・BUMP受託は伸び悩み、売上高は減少



## 2014年3月期 第3四半期実績増減分析(営業利益)

### 2013年度第3四半期累計実績(YoY)

- ・メモリ事業はモバイル製品が好調維持により売上高を牽引し、利益が改善
- ・システムLSI事業はテスト受託が緩やかに増加するがWLP・BUMPの売上高減少により、収益が悪化



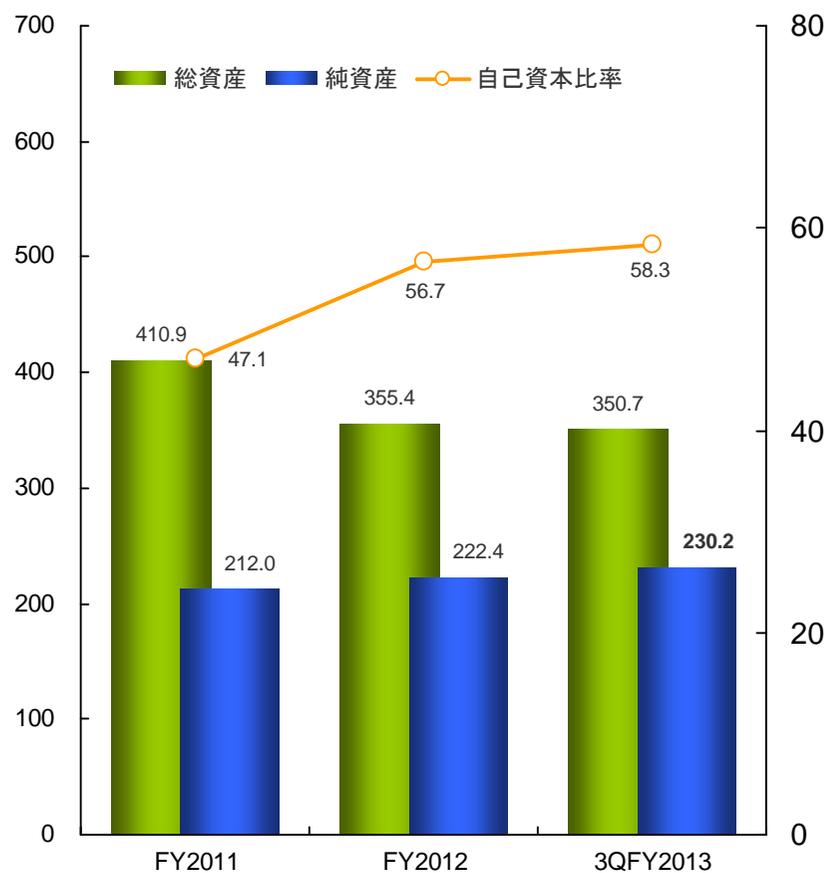
### 2013年度第3四半期実績(QoQ)

- ・メモリ事業は台湾の売上増や、費用の減少により収益が改善
- ・システムLSI事業は売上高の減少により収益が悪化

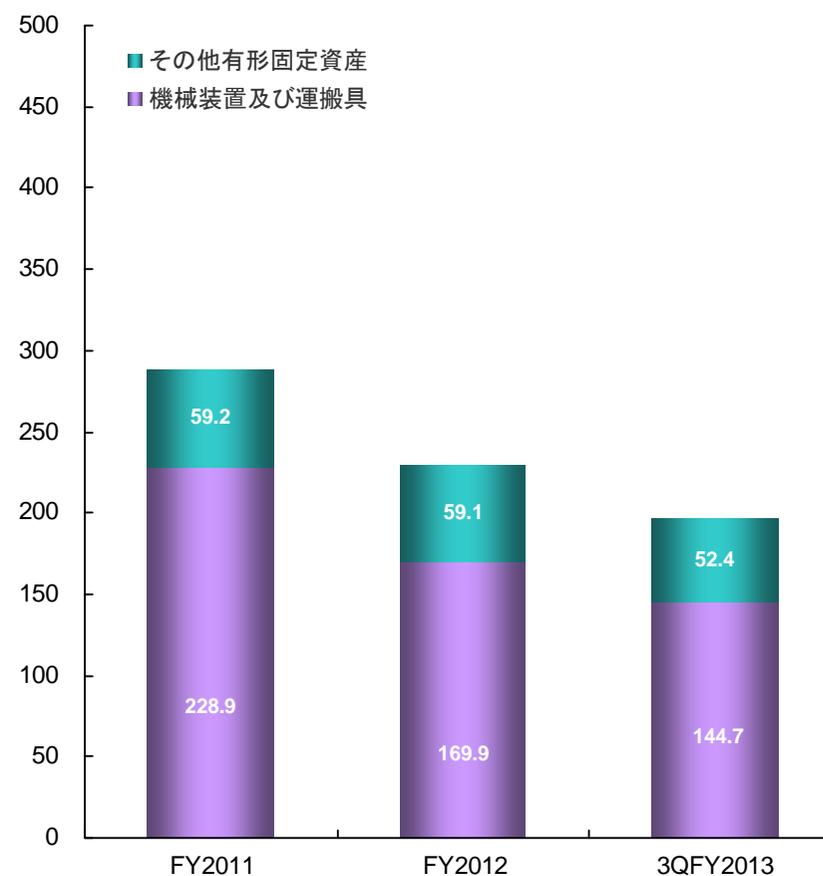


# 財務状況の推移①

## 総資産・純資産・自己資本比率



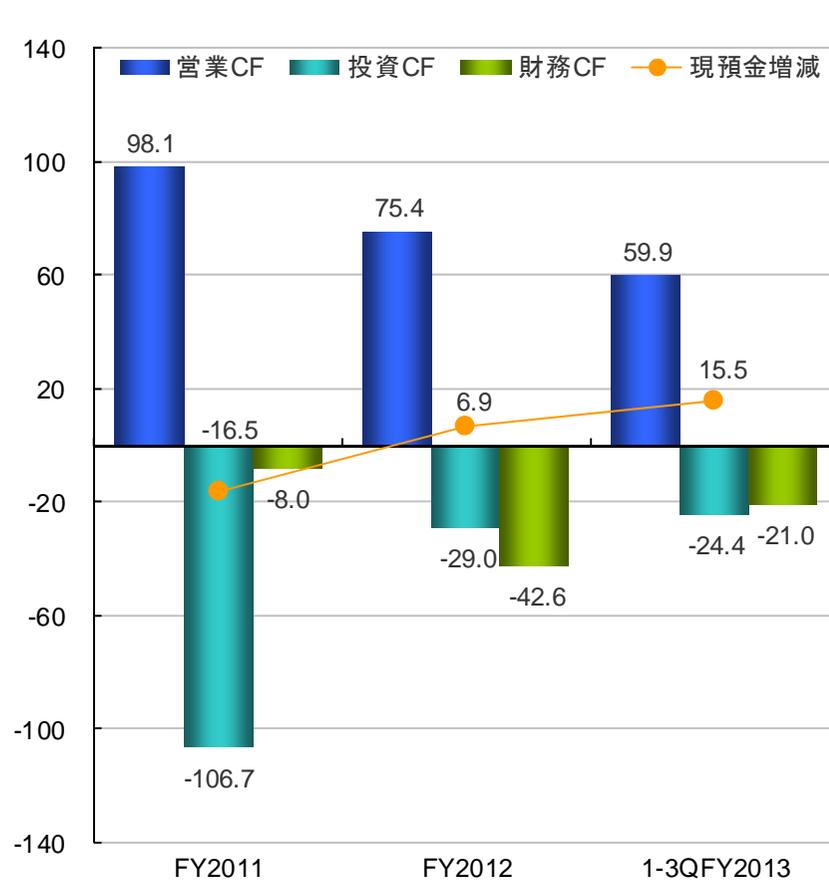
## 有形固定資産の推移



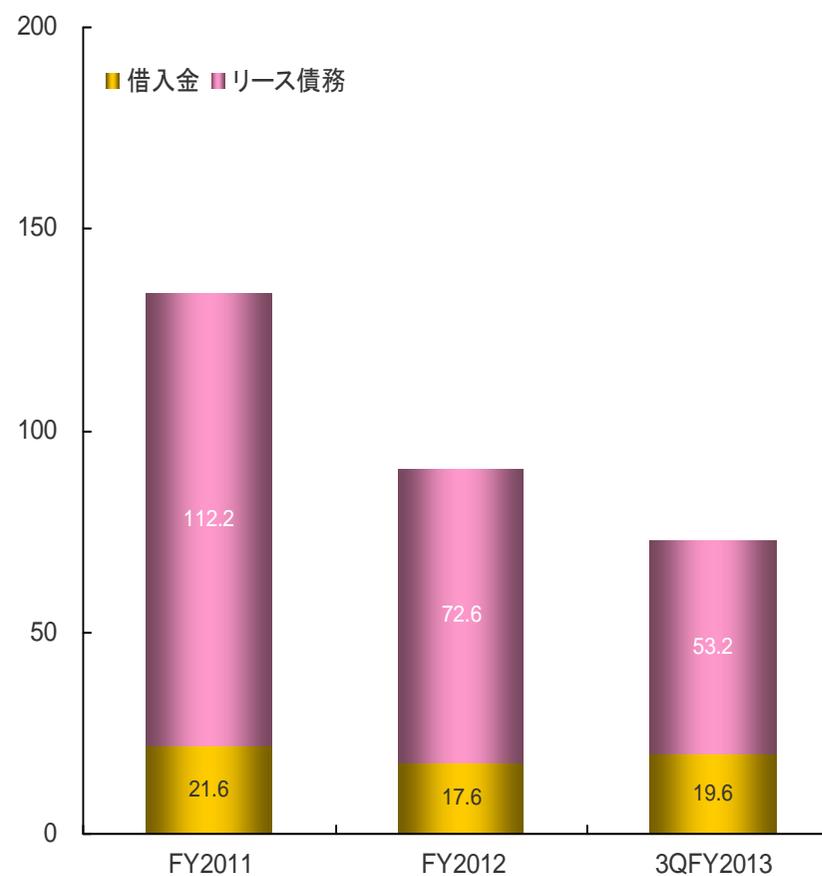
単位:億円

## 財務状況の推移②

### キャッシュフロー



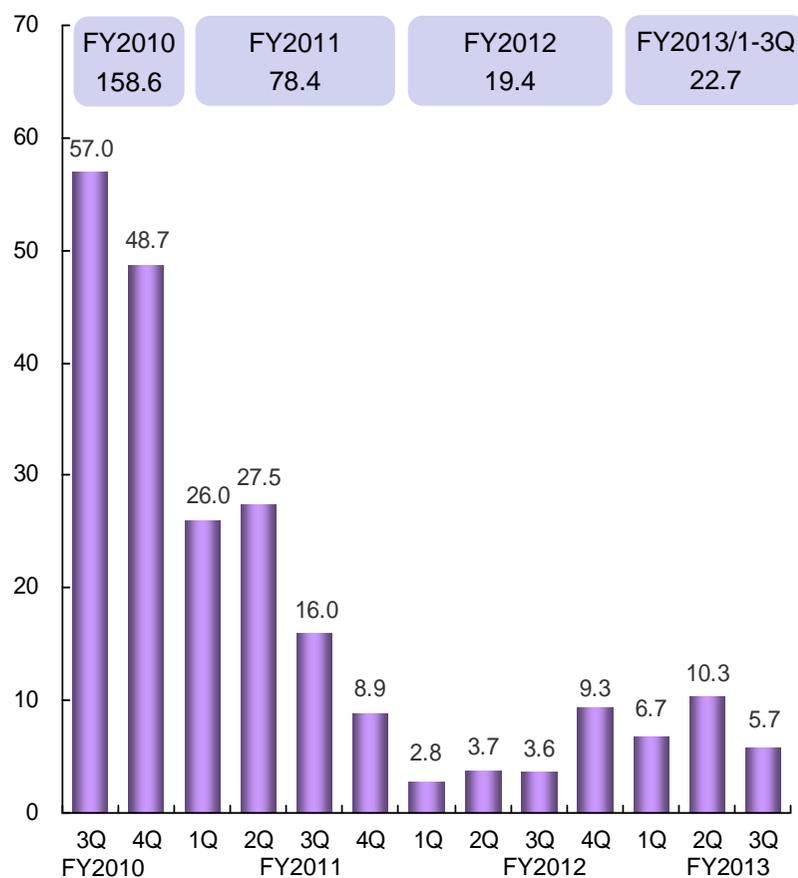
### 借入金・リース債務残高



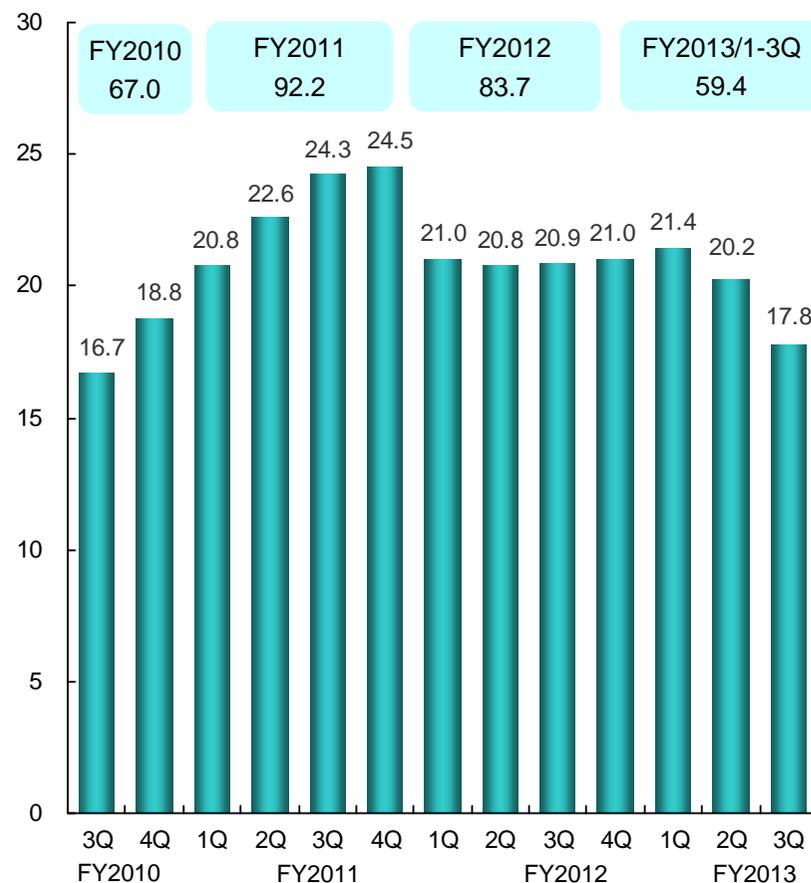
単位:億円

# 設備投資及び減価償却

## 設備投資額推移



## 減価償却費推移



単位: 億円

## 2014年3月期 第3四半期のトピックス

### インクジェットコーターの共同開発

WLPとバンプ向けポリイミドをインクジェット(IJ)方式で塗布するIJコーター  
特徴

1. 従来のポリイミド材を使用して、高品質、高効率の塗布が可能
2. 200～300mmウエハに対応し、膜厚をフレキシブルに調整することが可能
3. 凹凸の大きい再配線表面にも塗布が容易で、均一性にも優れている

### バンプレイン譲り受け

富士通セミコンダクター株式会社が保有する 300mm ウエハの  
バンプ工程に係る設備を譲受け、当該設備を使用する業務の受託を開始

# 2014年3月期第4四半期業績予想

## 2014年3月期 第4四半期業績予想の概要

### メモリ事業

- 稼働日の減少と、台湾でのモバイル用メモリの生産調整等により前四半期比で減少

### システムLSI事業

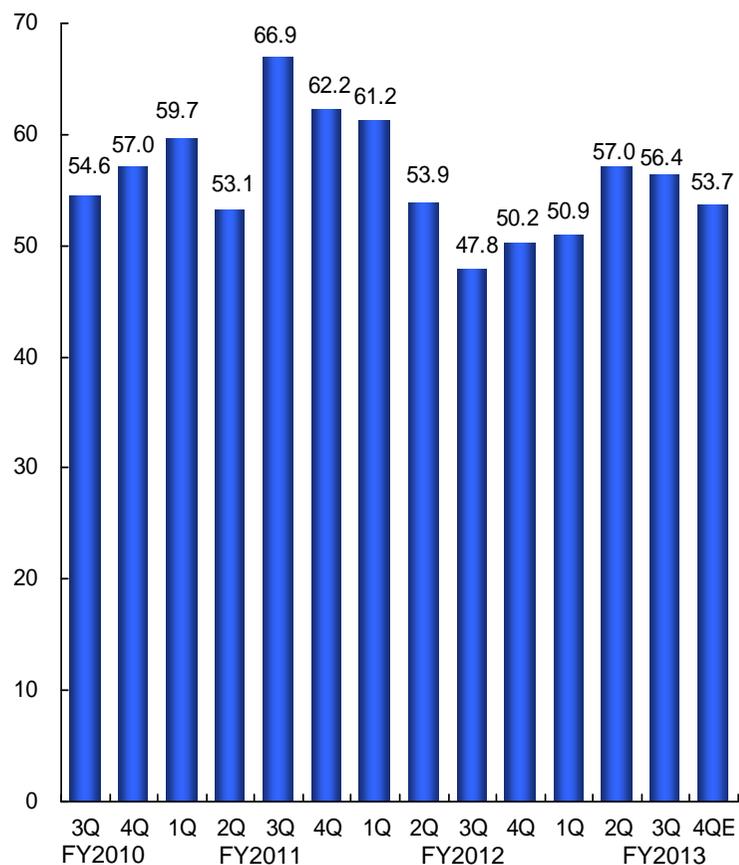
- テスト受託、WLP・BUMP受託とも前四半期に比べ緩やかに回復



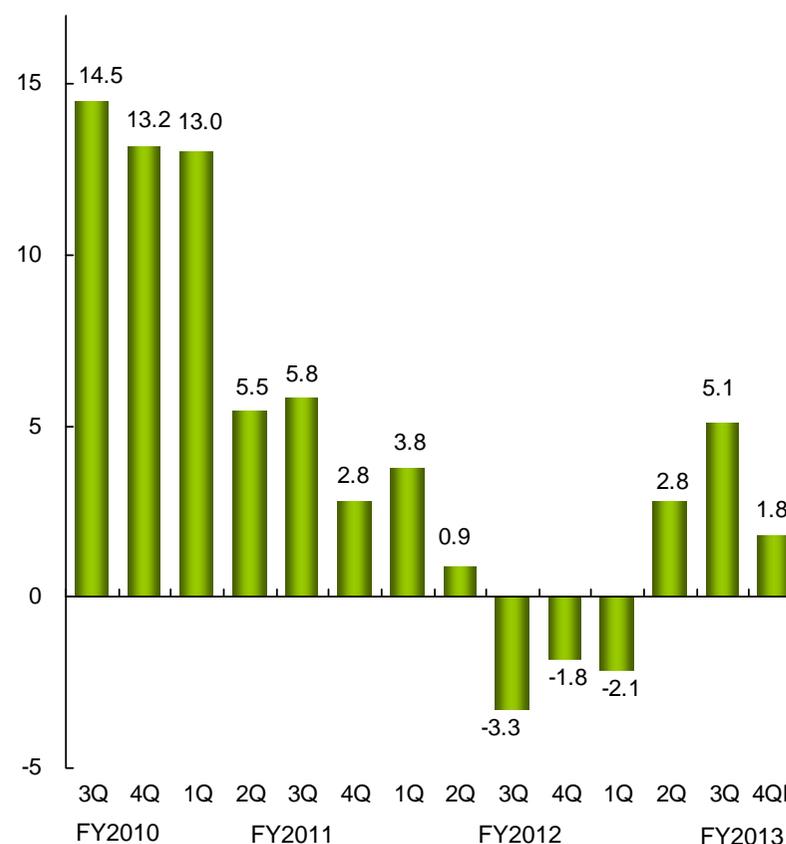
季節要因による生産調整もあり、  
売上高、利益ともに前四半期を下回る予想

# 売上高及び営業利益推移

## 売上高推移



## 営業利益推移



単位:億円

当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

## 2014年3月期 第4四半期のトピックス

### 先行技術開発室の設立

#### 《活動内容》 ソフトウェア開発・要素技術開発

##### ●画像処理技術を応用したソフトウェア開発

NEC製顔検出／顔照合エンジン「NeoFace」※のアルゴリズムを採用し、  
ARM Core※等に対応した製品開発



世界で販売されている様々なマイクロコントローラ製品向けに順次対応を拡大予定

##### ●生体信号を用いたヒューマンインターフェース技術の研究

ハンズフリーでのウェアラブル機器の操作や医療、福祉用途の身体情報収集など

※「NeoFace」は、日本電気株式会社の登録商標です。

ARM は ARM Limited の登録商標または商標です。その他、本記事中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

## 本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、2014年1月30日において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成26年3月期第3四半期決算短信」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ  
コーポレートプランニング・IR部門  
TEL (045)476-5711  
URL <http://www.teraprobe.com>